

策略周评 20260301

英伟达业绩超预期，AI眼镜抢占C端入口

2026年03月01日

本周AI要闻

- **事件 1:** 美东时间 2026 年 2 月 25 日周三盘后，英伟达公布了其 2025 财年第四季度财报。财报数据显示，2026 财年第四季度，英伟达该季度总营收为 681.3 亿美元，高于分析师预测的 662 亿美元的营收额；该季度的每股盈利为 1.62 美元，超过了华尔街分析师预计的每股 1.53 美元的水平。业绩指引同样好于预期。英伟达预计第一财季营收为 780 亿美元，上下浮动 2%。
- **事件 2:** 2026 年 2 月 27 日，美国科技公司谷歌宣布上架新一代图像生成模型 Nano Banana 2，使得高质量图像的生成更快、更便宜、更容易。谷歌宣称，Nano Banana 2（即 Gemini 3.1 Flash 图像模型）能够兼具 Nano Banana Pro 的图像生成质量、推理能力和先进世界知识，以及 Flash 模型的“闪电生成速度”。即日起，Nano Banana 2 已经成为谷歌 Gemini、搜索和视频编辑工具 Flow 中的默认图像模型。
- **事件 3:** 2026 年 2 月 27 日，阿里巴巴旗下个人 AI 助手“千问”正式进军 AI 硬件领域，今年将面向全球市场推出多款不同形态的 AI 硬件产品。千问将在 2026 年世界移动通信大会（MWC）上发布首款同名 AI 眼镜，并于 3 月 2 日开启线上线下全渠道预约。阿里内部人士对上证报记者表示，未来阿里巴巴所有新上市 AI 眼镜产品将统一以“千问 AI 眼镜品牌面向全球市场。已上市的夸克 AI 眼镜将与千问 AI 眼镜功能更新保持同步，持续享受千问 AI 服务。

（信息来源：上证证券报、财联社等）

周度观点

■ 英伟达业绩超预期，AI眼镜抢占C端入口

（1）本周全球 AI 产业延续算力、模型与应用协同推进的演进趋势，基础设施供给重构与终端形态创新两条主线同步展开。算力端，在需求高增背景下，英伟达持续强化龙头地位，Meta 等厂商推动多供应商并行布局，AI 芯片生态向多极竞争演进。模型端，厂商竞争重心转向速度、成本与系统集成能力，图像生成能力加速普惠化，AI 编码进一步嵌入企业研发流程，模型能力迈向效率与平台化整合。应用端，一方面通过 AI 眼镜等可穿戴设备强化 C 端原生入口布局，另一方面借助四足及工业机器人升级提升实体执行能力，推动 AI 由数字工具向现实场景持续渗透。整体来看，在算力格局重塑与模型效率提升基础上，AI 正加速向个人终端与物理执行系统双向延伸。

（2）算力与基础设施方面，本周 AI 产业在需求高增与供给重构并行背景下，呈现出龙头盈利强化与多元供应加速博弈的趋势。英伟达发布 2025 财年第四季度财报，营收同比增长 73%，数据中心业务同比增长 75%，并预计下一财季继续保持高增，同时展示新一代 Vera Rubin 系统，强化其在高端算力市场的技术领先地位。Meta 一方面扩大对英伟达 GPU 采购，另一方面与 AMD 达成多年期 6 吉瓦算力合作，既通过创新融资机制“循环融资”，将关键大客户锁定在使用其芯片技术的长期协议中，又通过租用谷歌 TPU 并探索直接采购，以开发新的人工智能模型，形成多供应商并行格局。整体来看，在 AI 基础设施需求持续高增的支撑下，算力格局正转向生态博弈与供应链重构并行演进，AI 芯片市场正由单一龙头主导向多极竞争加速演进。

（3）模型技术层面，本周各家模型竞争聚焦于速度、成本与系统集成能力的综合考量，展现出对生成能力高效化与 AI 编码嵌入企业研发流程的追求。海外方面，谷歌 DeepMind 推出新一代图像生成模型 Nano Banana 2，在接近高阶画质水平下显著提升生成速度与分辨率覆盖能力，并通过大幅

证券分析师 陈刚

执业证书：S0600523040001

cheng@dwzq.com.cn

证券分析师 谢立昕

执业证书：S0600525080001

xielx@dwzq.com.cn

相关研究

《两会前后的市场节奏和布局》

2026-03-01

《Seedance2.0 和人形机器人春晚出圈》

2026-02-23

降价与免费开放应用端使用，将图像生成推向“质量—速度—成本”三重平衡，同时深度嵌入搜索、云与广告体系，强化模型与业务场景的一体化整合。国内方面，华为云发布代码智能体公测版，将代码大模型、IDE与代码库理解能力整合为工程化 AI Coding 平台，并支持多模型接入与智能体扩展机制，推动模型能力向企业级研发流程嵌入；阿里开源千问 3.5 系列，通过架构与训练优化在中等规模模型上实现性能跃升，并降低部署门槛与调用成本，强化开发者生态适配。整体来看，模型技术正迈向高效化、低成本化与平台化集成并行发展的新阶段。

(4) 应用层面，本周呈现出 C 端入口硬件化与工业机器人智能化升级的趋势，AI 正以数字服务工具加速嵌入消费终端与实体生产系统。海外方面，Alphabet 将机器人软件公司 Intrinsic 整合至谷歌体系内，强化机器人软件与企业级 AI 能力协同，有助于谷歌将 AI 赋能制造与仓储自动化系统，通过软件层提升现有设备智能化水平。国内方面，阿里巴巴宣布将在世界移动通信大会（MWC）发布首款“千问”AI 眼镜，通过将 AI 能力直接嵌入可穿戴设备，使 AI 从应用软件形态进一步转向日常硬件载体，争夺下一代个人智能入口；宇树科技发布新一代四足机器人 Unitree As2，在动力性能、续航与复杂地形适应能力上显著提升，并开放二次开发生态与机械臂扩展能力，推动机器人在巡检、运输与复杂环境作业等场景的实用化落地。整体来看，AI 应用正向个人消费硬件入口和工业自动化系统延伸，应用边界持续向物理世界拓展。

(5) AI 产业趋势不变，把握春季躁动第二阶段。此前 AI 应用受流动性影响有所调整，但推动市场走强的有利因素并未发生改变，随着前期市场波动率逐步修复，市场有进入春季躁动行情的第二阶段。算力方面，英伟达财报超预期，有望推动全球 AI 重回上行周期；需求方面，中国模型的 Token 消耗量三周内增长 127%；市场方面，华为云发布代码智能体公测版等，入场 AI 开发工具赛道，增强投资者信心。

本周报告推荐

- **【东吴北交所】2025 业绩快报点评：全年扣非业绩同比+32%，看好储能/机器人/液冷新业务增量-开特股份（920978）**
- **【东吴电子】2026 年端侧 AI 产业深度：应用迭代驱动终端重构，见证端侧 SoC 芯片的价值重估与位阶提升**
- **【东吴电子】AI 基建，光板铜电—GTC 前瞻 Serdes, Rubin Ultra&CPO 交换机详解**
- **【东吴电子】端云协同驱动 AI 入口重塑与硬件范式重构-**
- **风险提示：美联储降息不及预期，AI 技术发展不及预期**

1. 重要数据跟踪

表1: 美国主要科技股周度表现 (2026/02/23-2026/02/27)

代码	证券简称	收盘价美元	市值亿美元	周涨跌幅	2026年初至今涨跌幅
NVDA.O	英伟达(NVIDIA)	177.19	43,057	-6.65%	-4.99%
MSFT.O	微软(MICROSOFT)	392.74	29,163	-1.13%	-18.61%
AAPL.O	苹果(APPLE)	264.18	38,785	-0.15%	-2.73%
GOOGL.O	谷歌(ALPHABET)-A	311.76	37,696	-1.02%	-0.40%
AMZN.O	亚马逊(AMAZON)	210.00	22,543	-0.05%	-9.02%
META.O	脸书(META PLATFORMS)	648.18	16,396	-1.14%	-1.80%
TESLA.O	特斯拉(TESLA)	402.51	15,104	-2.26%	-10.50%

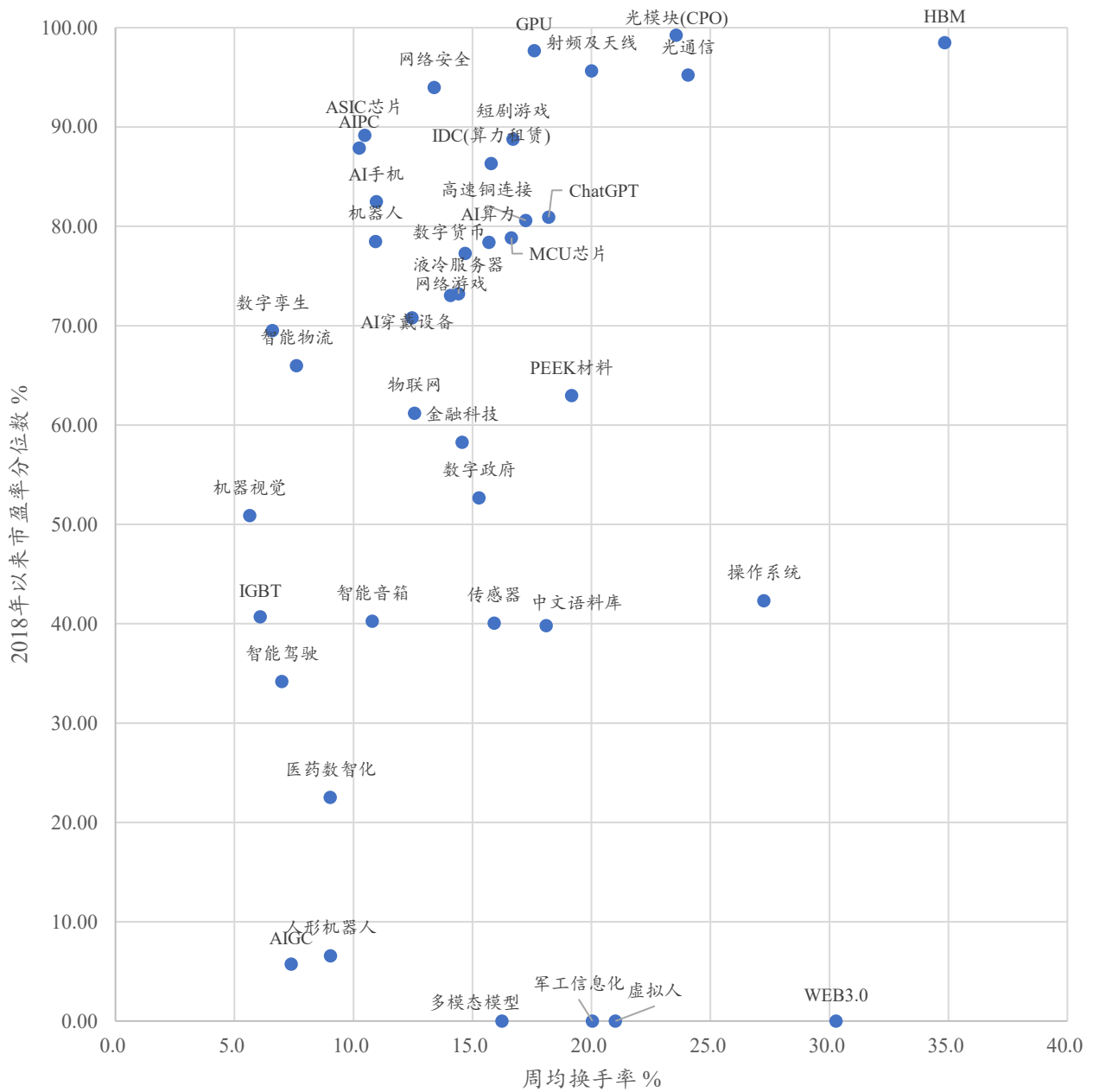
数据来源: WIND, 东吴证券研究所

图1: 主要科技指数的收益表现 (归一化)



数据来源: WIND, 东吴证券研究所

图2：A股主要AI概念指数情绪（截至2026年02月27日）



数据来源：WIND，东吴证券研究所

2. 人工智能报告推荐

表2：东吴人工智能报告推荐一览

发布时间	报告名称	核心内容	相关标的
2026/2/27	【东吴北交所】2025 业绩快报点评：全年扣非业绩同比+32%，看好储能/机器人/液冷新业务增量	业绩增长动因：汽车行业需求稳步增长，公司经营优化与产能扩张双轮驱动。高质稳定的客户群体与硬核的研发能力是公司发展两大支柱。	开特股份（920978）
2026/2/23	【东吴电子】2026 年端侧 AI 产业深度：应用迭代驱动终端重构，见证端侧 SoC 芯片的价值重估与位阶提升	AI 应用迭代驱动端侧硬件需求持续攀升，端侧高算力升级推动传统手机和 PC 端侧存量市场格局重塑，行业巨头需依托 AI 软件需求驱动硬件创新以巩固地位。端侧 AI 的产业发展趋势明确且确定，存储涨价压制只是短期扰动。	端侧 AI SoC 芯片：晶晨股份、瑞芯微、星宸科技、恒玄科技、乐鑫科技、地平线机器人（汽车&传媒互联网海外组覆盖）、黑芝麻智能（汽车&传媒互联网海外组覆盖）等； 端侧存储芯片：兆易创新等； 消费电子终端与供应链：立讯精密、歌尔股份、领益智造、东山精密、绿联科技（商社组覆盖）等； 端云生态：阿里巴巴（传媒互联网海外组覆盖）等
2026/2/25	【东吴电子】AI 基建，光板铜电—GTC 前瞻 Serdes, Rubin Ultra&CPO 交换机详解	SerDes 代际跃迁，驱动算力互联介质升级。Rubin Ultra 机柜有望推动 M9 材料与 NPO 光引擎迎确定性增长。	M9 PCB 产业链：菲利华、东材科技、生益科技、胜宏科技、沪电股份、深南电路、东山精密等； CPO 产业链：致尚科技、长光华芯、源杰科技、仕佳光子、太辰光、炬光科技、罗博特科等
2026/2/27	【东吴电子】端云协同驱动 AI 入口重塑与硬件范式重构	云端模型：能力边界外扩与成本重构并行。端侧模型：端云协同主线下的效率优化与能力压缩。端侧模型牵引硬件重构：算力、存力与散热协同升级。	

数据来源：东吴证券研究所整理（报告筛选标准为：本周公开已发布，对相关标的进行长期跟踪）

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

在法律许可的情况下,东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的,应当注明出处为东吴证券研究所,并注明本报告发布人和发布日期,提示使用本报告的风险,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的,应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期(A 股市场基准为沪深 300 指数,香港市场基准为恒生指数,美国市场基准为标普 500 指数,新三板基准指数为三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的),北交所基准指数为北证 50 指数),具体如下:

公司投资评级:

- 买入:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上;
- 增持:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间;
- 中性:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间;
- 减持:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间;
- 卖出:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级:

- 增持:预期未来 6 个月内,行业指数相对强于基准 5%以上;
- 中性:预期未来 6 个月内,行业指数相对基准-5%与 5%;
- 减持:预期未来 6 个月内,行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系,表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况,如具体投资目的、财务状况以及特定需求等,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码: 215021

传真: (0512) 62938527

公司网址: <http://www.dwzq.com.cn>